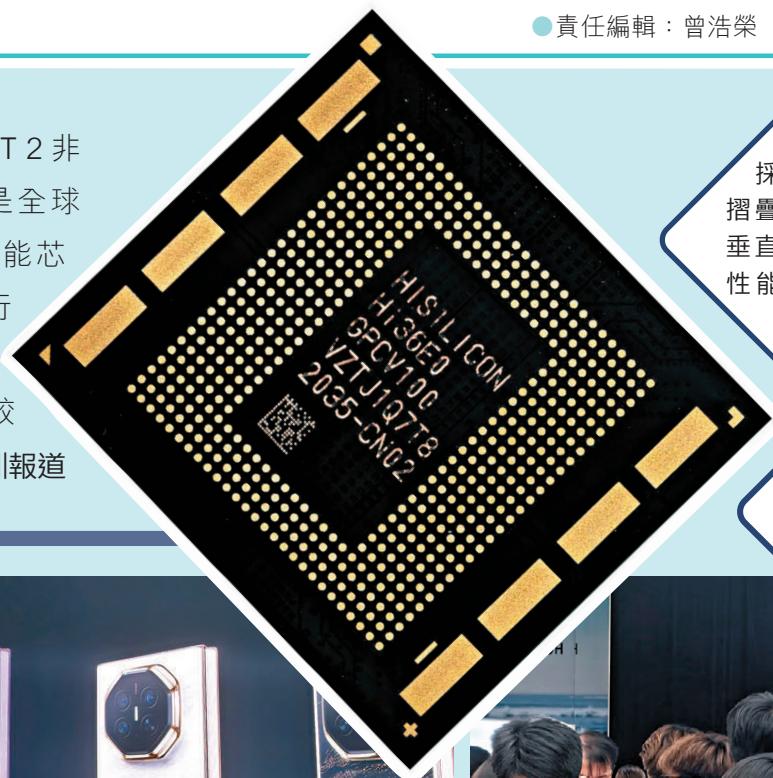


華為昨在廣州舉行全場景新品發布會，正式推出 Mate XT 2 非凡大師三摺疊手機，搭載最新的麒麟 9050 Pro 芯片。這是全球首款落地「韜（τ）定律」、採用邏輯摺疊技術的高性能芯片。華為常務董事、終端 BG 董事長余承東在當日舉行的發布會上表示，憑藉「軟、硬、芯、雲」的深度協同，搭載 9050 Pro 芯片的 Mate XT 2 整體性能可較上一代提升 42%。

●香港文匯報記者 郭若溪 深圳報道



- 麒麟 9050 Pro 芯片亮點**
- 1 採用邏輯摺疊技術，增設垂直互聯通道，性能能效雙重提升。
  - 2 原生運行盤古 30B-A2B 大模型。
  - 3 與鴻蒙 7 深度適配，軟硬芯雲協同，整體性能較上代提升 42%。
  - 4 集成靈犀 CPU、馬良 GPU、達芬奇 NPU，支持硬件光線追蹤。

整理：香港文匯報記者 郭若溪

●華為昨日在廣州發布 Mate XT 2 三摺疊手機，搭載最新的麒麟 9050 Pro 芯片。三摺疊 Mate XT 2 售價 19,999 元起。

香港文匯報記者郭若溪攝



●發布會結束後觀眾爭相體驗 Mate XT 2。香港文匯報記者郭若溪攝

推全新三摺疊手機 3nm 工藝性能提升 42%

# 華為「韜定律」加速突破 首發自研麒麟 9050 Pro 芯片

華為在今年 5 月首次提出韜（τ）定律，核心主張是以「時間縮微」替代「幾何縮微」，通過邏輯摺疊等技術持續壓縮信號傳播時延，在不大幅縮小晶體管尺寸的前提下實現整體性能躍升，目標是到 2031 年其高端芯片晶體管密度將達到 1.4 納米製程的同等水平。麒麟 9050 是這一理論從論文走向產品的首次實踐。這也是華為時隔六年再度在旗艦發布會上完整解讀全新麒麟旗艦芯片。

據介紹，麒麟 9050 Pro 芯片在單芯片內部將邏輯單元分層排布，由平層升級為複式結構，增設垂直互聯通道，猶如於芯片內部加裝「電梯」，縮短信號傳輸路徑，降低時延。該技術實現晶體管密度大幅提升，在同等性能條件下，CPU、GPU、NPU 各模塊功耗顯著優化，打破傳統芯片迭代路徑的局限。

官媒引述數據指，麒麟 9050 Pro 採用 3nm 級別工藝，芯片電晶體密度較傳統 2D 設計提升 53.5%。搭配首發 HarmonyOS 7，整體性能較上代提升 42%。具體來看，芯片集成靈犀 CPU、馬良 GPU、達芬奇架構 NPU 三大計算單元。靈犀 CPU 配合方舟引擎，大文件加載快人一步；運行多個 App 或多任務並行時更勝一籌。馬良 GPU 計算單元與緩存翻倍，渲染性能大幅提升，遊戲場景下支持 5,000 萬線硬件級實時光線追蹤。達芬奇架構 NPU 帶來端側 AI 算力躍升。

## 部分任務功耗降 66%

華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波近日在中國科學院科技論文預發布平台上發布論文表示，實測結果顯示，麒麟 9050 Pro 芯片相比上一代麒麟芯片（麒麟 9030 Pro），在每平方毫米上多容納了 55% 的晶體管，運行中卻更冷，並在部分關鍵任務上將功耗大幅降低了 66%。

麒麟 9050 Pro 是首款採用邏輯摺疊技術的高性能芯片，其晶體管密度在一代之內從每平方毫米約 1.55 億個提升到約 2.38 億個。「這一增幅相當於我們此前三年依靠幾何尺寸縮小所取得的成果總和。按直覺，功耗密度本應同步攀升，但它反而下降了。」何庭波介紹，與平面工藝的前代產品相比，在性能對齊的條件下，麒麟 9050 Pro 在真實負載基準測試中實現的功耗降低分別為：NPU 66%、GPU 58%、CPU 性能 41%。

## 新旗艦手機周六開售

搭載麒麟 9050 Pro 芯片的 Mate XT 2 非凡大師手機，採用三摺疊設計，完全展開可達 10.2 英寸 3K 超清大屏，並首發靈犀硬件級防窺屏，實現摺疊屏硬件層面防窺防護。該機售價 19,999 元人民幣起，將於本週六（9 月 12 日）開售。

當天，華為還正式推出新一代鴻蒙操作系統 HarmonyOS 7，該系統引入系統級智能體，基於方舟引擎的深度優化，HarmonyOS 7 整體性能提升 15%，續航延長 36 分鐘以上。余承東表示，鴻蒙終端設備數突破 8,500 萬，預計今年第四季度內有望突破 1 億。9 月 7 日起，HarmonyOS 7 面向首批多款機型陸續開放升級。



▲余承東展示三摺疊 Mate XT 2 手機。

香港文匯報記者郭若溪攝

## 華為小米蘋果 同周競推摺疊屏手機

### 正面交鋒

香港文匯報訊（記者郭若溪 深圳報道）本周，摺疊屏手機市場進入罕見的「超級發布周」。從昨日下午到 10 日凌晨，華為、小米、蘋果將在 72 小時內連發各自摺疊屏旗艦手機，三大品牌首次在同一周、同一品類上對面競爭。華為昨下午率先發布 Mate XT 2 非凡大師三摺疊手機，並首發搭載 HarmonyOS 7 操作系統。當晚小米首款摺疊手機小米 18 Fold 接力登場，以「闊摺疊」形態切入，搭載玄戒 O3 芯片，這也是小米摺疊屏產品首次採用該芯片。兩天後，蘋果首款摺疊屏手機也將正式亮相。

華為與蘋果在摺疊屏領域首次正面交鋒，小米同台競技。如此高密度的旗艦摺疊屏發布，在摺疊屏品類誕生

七年來尚屬首次。

### 比拚耐用性與實用性

專家表示，近年來手機企業面臨儲備器件不斷漲價、用戶換機周期拉長和出貨量下降的壓力，為維持營收和利潤，廠商紛紛將資源更多投向利潤空間更充足的中高端和摺疊屏市場。

摺疊屏市場經過多年發展已逐步成熟。2018 年 10 月 31 日，柔宇科技發布 FlexPai，開啟摺疊屏手機時代；2019 年三星推出 Galaxy Fold，成為最早入局的頭部廠商之一。此後，華為、OPPO、vivo、小米等相繼加入，產品覆蓋大摺疊、小摺疊、中摺疊等多種形態。如今，摺疊屏賽道正從「形態創新」步入「耐用性與實用性」的深度比拚。

## 邏輯摺疊量產落地 驗證技術路線可行

### 專家點評

繼今年 5 月對外發表「韜定律」後，華為昨推出首款採用邏輯摺疊技術的全新麒麟芯片。北京熙誠紫光科技有限公司董事劉寧寧接受香港文匯報採訪表示，麒麟 9050 Pro 首次實現邏輯摺疊架構在消費級芯片上的量產落地，是在摩爾定律邊際效益持續衰減的產業節點上，驗證了一條非製程驅動的性能提升路徑，為全球半導體產業的「後摩爾定律」時代提供了可落地的中國方案。

劉寧寧認為，從產業視角看，這一突破的意義超出單一產品迭代。對內地半導體產業而言，在受到國外製程限制的背景下，麒麟 9050 Pro 證明了架構創新可以部分抵消製程差距，為產業鏈自主可控開闢了新的技術路線。對全球半導體行業而言，韜定律與邏輯摺疊提供了「後摩爾時代」的演進範式，從單純的物理尺寸縮微，轉向系統級的時延與能效優化，為行業增長提供了新的技術錨點。

「作為全新架構的首次量產落地，邏輯摺疊技術路徑在生態適配、全場景驗證等方面仍有較長的路要走。但可以確定的是，麒麟 9050 Pro 問世標誌着中國半導體產業已從製程跟隨時期，進入架構創新的全新階段。」他說。

●香港文匯報記者郭瀚林 北京報道

亦正在競投埃及政府建設 AI 數據中心的項目，也印證中國 AI 技術出海突破，正在打破美方一手把持的全球 AI 產業格局。

知情人士表示，馬來西亞正在評估的是華為的昇騰 910C 產品，而非產量仍有限但更先進的昇騰 950 系列。美國政府團隊去年曾出言恐嚇，在世界上任何地方使用華為的昇騰人工智能芯片都會違反其所謂的出口管制規定，暴露了其試圖壟斷全球 AI 基建、打壓各國自主技術選擇的科技霸權圖謀。

### DeepSeek 傳將購至少 16 萬顆昇騰芯片

另一邊，彭博報道，DeepSeek 計劃在其建設中

的內蒙古大型數據中心，部署至少 16 萬顆華為最先進的 AI 芯片，即昇騰 950DT 芯片用於模型推理。這可能打造出目前已知規模最大的華為 AI 芯片集群之一，並推動中國進一步減少對英偉達芯片的依賴。不過具體安裝時間將取決於華為的生產能力。

報道稱，DeepSeek 希望採購更多華為最先進芯片，但華為目前產能不足。受高端存儲器等零組件短缺制約，華為今年 950DT 的產量將被限制在幾十萬顆這一量級的低端。華為還需要平衡其他客戶需求，並嘗試向海外出口少量產品，因此完成 DeepSeek 這筆訂單可能需要一年以上。

### 國際認可

## 馬來西亞擬採購華為 AI 芯片

香港文匯報訊（記者 周曉菁）華為芯片等中國高技術產品發展近年來持續受到美國限制及干擾，然而似乎難以阻礙中國技術獲國際市場認可。外電報道稱，馬來西亞傾向在國家主權人工智能項目中，採用華為的人工智能芯片。報道稱，在美國政府強烈反對的大背景下，這將成為中國 AI 技術的一項重要勝利。

彭博報道引述知情人士指，馬來西亞政府認真評估將華為 AI 硬件，作為規模近 5 億美元 AI 項目

的核心，以增強對國家數據的掌控力。馬來西亞總理安華表示，不希望國家只是成為海外技術的消費者。除了可能由華為提供硬件基礎設施外，安華政府亦鼓勵當地電信營運商和外國企業合作，提出更廣泛的人工智能發展框架。

若馬來西亞最終決定採用華為的人工智能芯片，將成為已知首個選擇中國 AI 加速器而非美國產品的外國政府案例，亦意味安華頂住了美國企圖加強控制全球 AI 基礎設施的壓力。同時，華為